

合肥晶合集成电路股份有限公司

2025 年半年度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩指引情况

（一）业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

（1）经合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现营业收入 507,000 万元至 532,000 万元，与上年同期相比，将增加 67,222 万元至 92,222 万元，同比增长 15.29%至 20.97%。

（2）预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 26,000 万元到 39,000 万元，与上年同期相比，将增加 7,300 万元到 20,300 万元，同比增长 39.04%到 108.55%。

（3）预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,700 万元到 23,500 万元，与上年同期相比，将增加 6,233 万元到 14,033 万元，同比增长 65.83%到 148.22%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2024 年半年度，公司实现营业收入 439,777.73 万元；归属于母公司所有者的净利润 18,700.25 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 9,467.49 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、报告期内，随着行业景气度逐渐回升，公司产品销量增加，整体产能利用率维持高位水平，助益公司营业收入和产品毛利水平稳步提升。

2、公司持续扩大应用领域及开发高阶产品，提升产品竞争优势及多元化程度。DDIC 继续巩固优势，CIS 成为公司第二大主轴产品，其他产品竞争力持续稳步提升。经财务部门初步测算，2025 年上半年 CIS 占主营业务收入的比例持续提高。

3、公司高度重视研发体系建设，持续增加研发投入，报告期内研发投入较去年同期增长约 15%，以保证技术和产品持续创新，提高产品市场竞争优势。目前公司 40nm 高压 OLED 显示驱动芯片已实现批量生产，55nm 全流程堆栈式 CIS 芯片实现批量生产，28nm OLED 显示驱动芯片及 28nm 逻辑芯片研发进展顺利，预计今年年底可进入风险量产阶段。后续公司将加强与战略客户的合作，加快推进高阶产品开发。

四、风险提示

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，为公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据。截至本公告披露日，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2025 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日